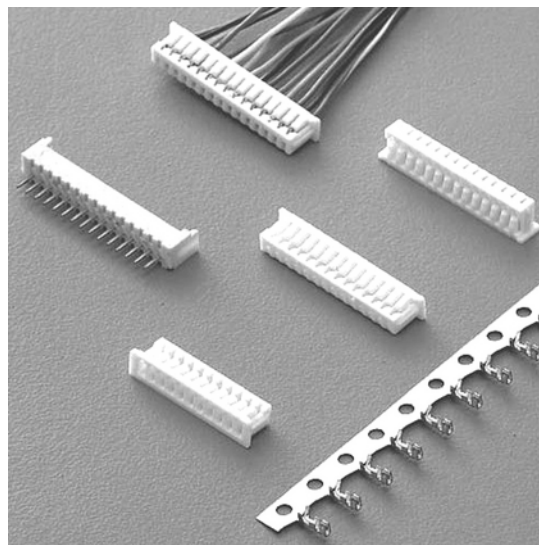


# Stift-/Buchsenleisten - Crimp-Rast-System - RM 1,25mm

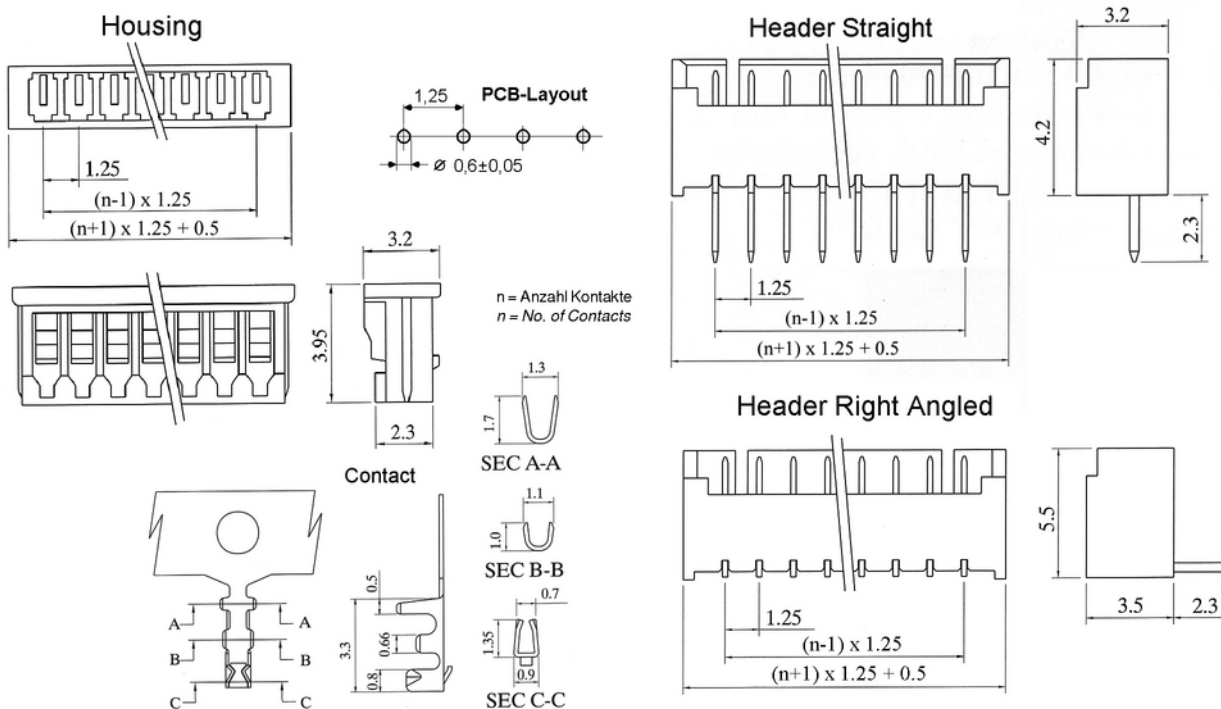
## Friction Lock Header and Crimp Housing - Pitch 1,25mm

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Messing, verzinkt
Contact Material	Brass, tin plated
Aderquerschnitt	AWG 28 ... 32
Applicable wire Gauge	AWG 28 ... 32
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 5x10 <sup>8</sup> Ω
Insulation Resistance	> 5x10 <sup>8</sup> Ω
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	100V <sub>AC/DC</sub> max.
Voltage Rating	100V <sub>AC/DC</sub> max.
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Wave soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts*	Type*	Plating
<b>560</b>	<b>10</b> 02-15	<b>3</b> 1 Buchsengehäuse Housing 2 Buchsenkontakte Crimp contacts 3 Stiftleiste gerade Straight pin header 4 Stiftleiste gewinkelt Right angled pin header	<b>50</b> 50 Verzinkt (für Gehäuse nicht erforderlich) Tin plated (not used for housings)

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

(\* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX.: +49 5223 98507-50

# W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com  
INTERNET: www.wpro.com

# Informationen zum Wellenlötverfahren

## Wave Soldering Information

### Wellenlötverfahren Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei 260°C für max. 5 Sekunden verarbeitet werden.  
Items should be soldered at 260°C for max. 5 seconds.

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
Recommended wave soldering profile:

